

实用表面组装技术



[实用表面组装技术_下载链接1](#)

著者:张文典

出版者:电子工业出版社

出版时间:2002-2

装帧:

isbn:9787505373730

表面组装技术（SMT）发展已有近40年的历史，现已广泛应用于通信、计算机、家电行

业，并正在向高密度、高性能、高可靠性和低成本方向发展。
本书较详细地介绍了SMT的相关知识。全书共有十五章，包括焊接机理、SMT工艺设计的要求。热传导基本概念、各种辅助材料的特性与评估方法、各种焊接设备的热传导特点以及焊接曲线的设定、贴片机验收标准、焊点质量评价与SMA性能测试技术、SMT大产生中的防静电及质量管

作者介绍:

目录: 前言
第1章 概论
1.1 表面组装技术的优点
1.2 表面组装和通孔插装技术的比较
1.3 表面组装的Xi艺流程
1.4 表面组装技术的组成
· · · · · (收起)

[实用表面组装技术_下载链接1](#)

标签

评论

[实用表面组装技术_下载链接1](#)

书评

[实用表面组装技术_下载链接1](#)